

EDITORIAL

Laser – ein universelles Werkzeug
auch in elektronischer Forschung und Technologie 1609

VERBÄNDE

 **FBdi** - Informationen 1652
Fachverband Bauelemente Distribution e.V.

 **FED** - Informationen 1668

 **ZVEI** - Informationen 1698
Die Elektroindustrie

 **MAPS** - Mitteilungen 1729
DEUTSCHLAND

 **3-D MID** - Informationen 1740

 **DVS** - Mitteilungen 1765

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 1612

Neue Normen 1635

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1636

BAUELEMENTE

Effizienz und Zuverlässigkeit
diverser Anwendungen verbessert 1643

Hy-Line punktet mit aktuellen Leistungsbausteinen 1646

Mit Smartphone und Tablet jetzt Licht und Farben
von LEDs flackerfrei regeln 1649

Hörbarer Motorenklang bei Elektrofahrzeugen
sorgt für mehr Sicherheit 1650

Recom warnt vor gefälschten Bauteilen 1651

Anreihbare SMT-Kompakt-Anschlussklemme 1651

DESIGN

Video Development Kit – die Plattform OZ745 vereinfacht
das Design von Broadcast-Applikationen 1655

Aktualisierte Version des 3D-PCB-Designtools Altium
Designer und Anschluss an die Webench Tools von TI 1658

Produktangebot für die Industrie-Automation erweitert 1660

Mit iPad-App Schaltungsentwürfe überall
und jederzeit simulieren 1662

Version V17 des EDA-Tools Target 3001! ist erschienen 1663

Mentor Graphics und Digi-Key machen professionelle
EDA-Software für alle Entwickler zugänglich 1664

Dell soll helfen, das drahtlose Laden
auf Laptops auszudehnen 1666

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit):
Continental und Bosch sind Weltmarktführer für ECU's 1673

Leiterplattenfertigung – wenn Präzision noch präziser wird 1665

Die bleifreie HAL-Oberfläche – besser als Ihr Ruf 1678

Erster US-Leiterplattenhersteller nach IPC-Richtlinie
für den Schutz des geistigen Eigentums zertifiziert 1680

Starrflex-Leiterplatte legt sich zuverlässig in jede Kurve 1684

Ein guter Jahrgang – die neuen Galvano-
und Leiterplattentechniker 1686

Neue Lötspitzen in drei Produktfamilien von Weller
jetzt bei Conrad Business Supplies 1688

Leiterplatten in variablen Winkeln verbinden 1689

Die japanische Leiterplattenindustrie 1690

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Schlüsselprojekt eRamp zur Stärkung
der europäischen Elektronikindustrie gestartet 1706

Nutzentrenner für sicheres und günstiges Nutzentrennen 1710

Umweltfreundliches Reinigungssystem für Kondensatfallen
und Lötrahmen 1712

Mit LDS-fähigem Pulverlack werden Metallkörper
zu 3D-Schaltungsträgern 1714

Geruchsarme Reinigung von Lotrahmen
und Kondensatfallen 1715

Neue Familie von Intel-basierten Industrieboards 1716

Rückstände auf Baugruppen und Leiterplatten –
die Sache mit dem Reinigungsprozess 1717

Oberflächenmontage mit Nebenwirkungen
im Blickpunkt des CK Technologietags 1719

Erste gemeinsame Technologietage von SmartRep und SMT 1723

Lötprozess live – ein neues Technology Center
macht es möglich 1727

ANALYTIK & TEST

Interconnect-Option für PXI-Tester	1733
Analyse-Software SI 7.47 für Inspektionssysteme	1734
Schnelles Schalten und Signal-Routing	1735
Boundary Scan Days 2014	1736

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Microbearbeitung von glasfaserverstärkten, flexiblen und nanobeschichteten Leiterplatten mittels ultrakurzer Laserpulse	1744
Innovative 3D-MID-Technologie	1749
Patente	1759

FORUM

Microelectronics Saxony – Wegbereiter einer digitalen Welt	1766
Führende Elektronikunternehmen gründen Open Interconnect Consortium	1777
Japanische OEM treiben die Lade-Infrastruktur für Elektro- autos voran – während Deutschland noch forscht	1779
Kolumne: Dreht man bei Ihnen auch krumme Dinger?	1784
PLUS-Firmenverzeichnis	1787
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1811
Inserentenindex	1813
Stellenmarkt	1813
Mediadaten	1814
Impressum	1815
Produkt des Monats	1816

Titelbild: BJZ ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger und kompetenter Partner der Elektronikindustrie. Durch langjährige Erfahrung haben wir uns als innovatives und expandierendes Unternehmen in den Bereichen des EGB-Schutzes, der Bauteilvorbereitung und der Nutzentrenntechnik eine solide Marktposition gesichert. Führende Unternehmen der Elektronikindustrie vertrauen seit Jahren auf die Fachkompetenz und Produkte der Firma BJZ.

Lesen Sie ab Seite 1710 einen Beitrag über Nutzentrenner

www.bjz.de

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente
Distribution e.V.
Tel. +49 (0) 8563 9788908
w.ziehfuuss@fbdi.de, www.fbdi.de



Fachverband Electronic
Components and Systems
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org



Fachverband Elektronik-Design e.V.
Tel. +49/30/8349059
info@fed.de, www.fed.de



Fachverband PCB
and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS
AND PACKAGING SOCIETY –
Deutschland e.V.
Tel. +49/3677/69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de



Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49/91 1/5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de



European Interconnect
Technology Initiative e.V.
Tel. +49/69/6302-281
eiti@zvei.org, www.eiti.org



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49/211/1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.